

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于申请银行授信额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

为满足全资子公司南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）的日常生产经营及相关项目建设、投资等相关资金需求，便于南京伟测各项业务正常开展，南京伟测拟向合作银行申请总额不超过人民币 1.00 亿元银行授信额度，用于其在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池质押融资业务、国内外信用证、国际贸易融资、国内买方保理、外汇衍生交易信用额度、国内保函、商票保贴、供应链融资等业务。具体明细如下：

单位：万元

序号	授信方	授信金额	授信期限	额度使用单位
1	中国农业银行股份有限公司	10,000	1 年	南京伟测
合计		10,000		

具体融资金额在综合授信额度内，根据实际资金需求情况确定。授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

南京伟测将结合资金需求情况决定是否分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施、抵押等相关内容均以与银行所签订合同约定为准。

签订上述授信额度相关协议的有效期为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。为提高融资效率，董事会授权公司董事长骈文胜先生或其授权代表在上述授信额度范围内审核并签署相关合同文件。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日